(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年4 月21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/036628 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/301, 21/68

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014198

(22) 国際出願日: 2004 年9 月29 日 (29.09.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-351900
2003 年10 月10 日 (10.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辻本正樹 (TSUJIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吉岡孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

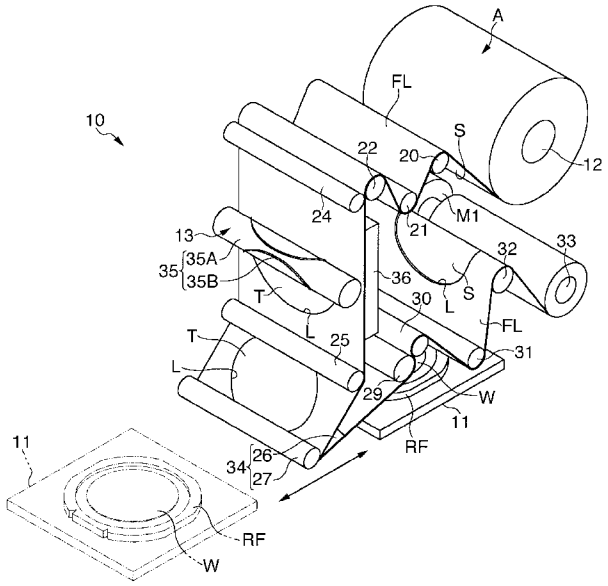
(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: MOUNTING DEVICE AND METHOD

(54) 発明の名称: マウント装置及びマウント方法



(57) Abstract: A mounting device capable of forming a dicing tape during the process of paying out a band-like raw material and fixing a semiconductor wafer by adhering the dicing tape to the ring frame. A mounting device (10) for fixing a semiconductor wafer (W) to a ring frame (RF) by adhering a dicing tape with the ring frame and the semiconductor wafer arranged on a table (11). The mounting device (10) has pre-cut means (13) and bonding means (34). The pre-cut means provides, in the process of paying out a band-like raw material (A), a half- cut incision (L) in a film (FL) surface of a band-like raw material (A) to form a dicing tape (T). The bonding means (34) separates the dicing tape from a base sheet (S) and adheres the tape to the ring frame (RF).

(57) 要約: 帯状素材を繰り出す過程でダイシングテープを形成し、当該ダイシングテープをリングフレームに貼着して半導体ウエハを固定できるマウント装置を提供する。 テーブル１１にリングフレームＲＦ及び半導体ウエハＷを配置した状態でダイシングテープを貼着して半導体ウエハをリングフレーム

[続葉有]

WO 2005/036628 A1

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

に固定するマウント装置１０。このマウント装置１０は、帯状素材Ａを繰り出す過程で当該帯状素材Ａのフィルム ＦＬ面にハーフカット状の切り込みＬを設けてダイシングテープＴを形成するプリカット手段１３と、ダイシングテープをベースシートＳから剥離してリングフレームＲＦに貼着する貼合手段３４とを備えている。